

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

[China reine Kupferplattenfabrik](#)

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

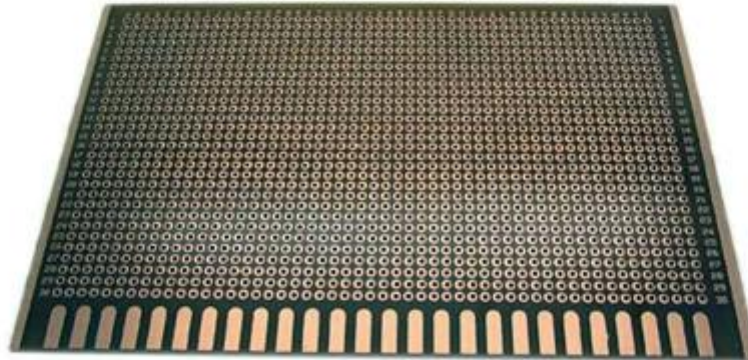
Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Hersteller von Leiterplatten auf Kupferbasis](#)

Produktbeschreibung

PCB P / N.	LE-150
Ebenenanzahl	1L
Material	Basiskeramik
Board thk	3,2 mm
Kupfer thk	1 Unze
Kleinste Lochgröße	/.
Anzahl der Löcher (Stk.)	/.
Linie w / s	/.
Impedanzregelung. J / N (Tol%)	N.
Oberflächenveredelung	ENIG (Au: 0,05 um)
Lötmaske Siebdruck	Schwarz-Weiss
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 45
Panelisierung	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 135; Anzahl der USV: 3
Besonderheit: abziehbare Maske	N.
Routing / Stanzen	CNC + Senkkopfschraube

•



www.o-leading.com

Hersteller von Leiterplatten auf Kupferbasis in China

Unser Team





Zertifizierungen



CICC INSPECTION CERTIFICATION



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 16118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-17-2

Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONG COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN ST. CHEUNG SHA WAN, KL, HK

Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018
This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification registration scope shall include those products/services scopes which fall to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.cn.






201726 2016VZL40354 - Wiring, Printed - Component



ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [UL Product Databases](#). Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width			SS/ DS/ Diam	Area	Solder Limits	Dper	Temp	Flame	RoHS	C
	Min	Max	Max								
Min Edge	Min	Cond	SS/ DS/ Diam	Area	Solder Limits	Dper	Temp	Flame	RoHS	C	
Typ	mm(in)	mm(in)	mil(mm)	mm ² (in ²)	mm(in)	°C	sec	°C	Class	DSR	I
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401											
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-
Multi-layer printed wiring boards.											
O-LEADING-408											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31(1.25)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	1
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002											
	0.76 (0.03)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-
O-LEADING-003											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-
O-LEADING-205											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-
O-LEADING-206											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification. Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

http://www.ul.com/ulcertification/60354/2016VZL40354-01/Wiring,Printed-Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "r" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce that it has been awarded the ISO 9001:2015 certification for its Quality Management System. This certification is valid for the period from 2018 to 2021. SGS is a member of the Bureau Veritas Group. For more information, please visit www.sgs.com. SGS is a member of the Bureau Veritas Group. For more information, please visit www.sgs.com.

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller
Lieferdetail	7-12 Tage



FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → innerer Trockenfilm → inneres Ätzen → innerer AOI → Mehrfachbindung → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → äußeres Ätzen → äußerer AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.